

2024 年 09 月 08 日

电子

SDIC

行业周报

证券研究报告

华为三折叠手机开启预订，荷兰升级 DUV 光刻机出口管制

投资评级 **领先大市-A**
维持评级

目 华为三折叠屏手机开启预订，超 200 万人预约

9 月 7 日，华为三折叠屏手机正式开启预订。海报还正式公布了华为三折叠的外观，采用独特镜头纹理，以及高辨识度的小金标。据悉，这款产品将于 9 月 10 日的华为发布会上正式推出，价格也有待届时揭晓，将于 9 月 20 日正式开售。预订通道刚开启，人数就迅速破万，预订开启不到 24 小时，华为商城显示该产品预约人数已超 200 万。

目 荷兰扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施

9 月 6 日，荷兰政府宣布扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，即从 9 月 7 日起，更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。措施规定，公司在出口此类先进制造设备时必须申请授权，政府将根据具体情况对申请进行评估，措施适用于从荷兰出口到欧盟以外的目的地。对于这一措施，荷兰光刻机巨头阿斯麦回应称，根据更新的许可证要求，阿斯麦将需要向荷兰政府而不是美国政府申请 TWINSCAN NXT:1970i 和 1980i 浸没式 DUV 光刻机的出口许可证。TWINSCAN NXT:2000i 及其后的浸没式 DUV 系统已经有了荷兰出口许可证要求。阿斯麦 EUV 系统的销售也受许可证要求的限制。阿斯麦表示，这是一项技术性变更，预计不会对公司 2024 年的财务前景或长期方案产生任何影响。

目 电子本周跌幅 5.27% (22/31)，10 年 PE 百分位为 27.72%:

(1) 本周 (2024.09.02-2024.09.06) 上证综指下跌 2.69%，深证成指下跌 2.61%，沪深 300 指数下跌 2.71%，申万电子版块下跌 5.27%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 22/31。2024 年，电子版块累计下跌 17.49%。(2) 其他电子设备跌幅最小，为 -0.42%；元件跌幅最大，为 -7.12%。(3) 电子版块涨幅前三公司分别为深圳华强 (+61.05%)、伟时电子 (+61.05%)、科森科技 (+60.90%)，跌幅前三公司分别为智动力 (-22.71%)、胜宏科技 (-19.75%)、沃尔核材 (-18.43%)。(4) PE: 截至 2024.09.06，沪深 300 指数 PE 为 10.52 倍，10 年 PE 百分位为 8.14%；SW 电子指数 PE 为 27.72 倍，10 年 PE 百分位为 15.79%。

首选股票	目标价 (元)	评级

行业表现



资料来源: Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-1.0	3.5	-3.1
绝对收益	-4.4	-6.5	-18.3

马良 分析师

SAC 执业证书编号: S1450518060001

maliang2@essence.com.cn

郭旺 分析师

SAC 执业证书编号: S1450521080002

guowang@essence.com.cn

吕众 分析师

SAC 执业证书编号: S1450524040001

lvzhong@essence.com.cn

朱思 分析师

SAC 执业证书编号: S1450523090002

zhusi1@essence.com.cn

盛晓君 分析师

SAC 执业证书编号: S1450523080001

shengxj@essence.com.cn

程宇婷 分析师

SAC 执业证书编号: S1450522030002

chengyt@essence.com.cn

相关报告

华为发布亮眼中报，IDC 上调 2024-09-01
调全年智能手机出货预期

投资建议：

华为产业链建议关注：芯海科技、天音控股、东睦股份、欧菲光、昀冢科技、电连技术、华丰科技、鸿日达、恒铭达；

半导体设备零部件关注：北方华创、中微公司、中科飞测、精测电子、拓荆科技、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材、江丰电子、正帆科技。

风险提示：

下游需求不及预期，技术研发不及预期，补贴政策效果不及预期。

AI 应用处理器增长快速，国内半导体设备 7 月进口额创新高	2024-08-25
AI 手机渗透率有望逐步提升，首届华为海思全联接大会 9 月初举行	2024-08-18
苹果产业链复盘与展望——AI 强化平台生态，2025 创新大年可期	2024-08-18
2024 年 Q2 全球半导体市场增长强劲，中国集成电路表现突出	2024-08-11

目 录

1. 本周新闻一览	4
2. 行业数据跟踪	6
2.1. 半导体：二季度供应链急单助力晶圆代工利用率，全球前十大晶圆代工产值季增 9.6%	6
2.2. SiC：芯片制造关键技术首次突破	8
2.3. 消费电子：华为三折叠屏手机开启预订，超 200 万人预约	9
3. 本周行情回顾	10
3.1. 涨跌幅：电子排名 22/31，子板块中其他电子跌幅最小	10
3.2. PE：电子指数 PE 为 27.72 倍，10 年 PE 百分位为 15.79%	11
4. 本周新股	13

目 录

图 1. 台积电月度营收	6
图 2. 世界先进月度营收	6
图 3. 联电月度营收	6
图 4. 新能源汽车产销量情况	8
图 5. 光伏装机情况	8
图 6. 国内智能手机月度出货量	9
图 7. 国内智能手机月度产量	9
图 8. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额	9
图 9. Steam 平台 VR 月活用户占比	9
图 10. 本周各行业板块涨跌幅（申万一级行业分类）	10
图 11. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万二级行业分类；%）	10
图 12. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万三级行业分类）	10
图 13. 本周电子板块涨幅前十公司（%）	11
图 14. 本周电子板块跌幅前十公司（%）	11
图 15. 电子板块近十年 PE 走势	11
图 16. 电子板块近十年 PE 百分位走势	12
图 17. 电子板块子板块近十年 PE 走势	12
图 18. 电子板块子板块近十年 PE 百分位走势	12
表 1：本周电子行业新闻一览	4
表 2：本周 IPO 审核状态更新	13

1. 本周新闻一览

表1：本周电子行业新闻一览

赛道	日期	来源	内容
半导体	9月2日	TrendForce 官微	二季度中国 618 年中消费季的到来，以及消费性终端库存已回归健康水平，客户陆续启动消费性零部件备货或库存回补，推动晶圆代工厂接获急单，产能利用率显著提升，较前一季明显改善。同时，AI 服务器相关需求续强，推升第二季全球前十大晶圆代工产值季增 9.6%至 320 亿美元。
	9月5日	全球半导体观察	盛美半导体宣布，公司已收到四台晶圆级封装设备的采购订单。其中两台来自一家美国客户，另外两台来自一家美国研发(R&D)中心。四款设备支持一系列先进的封装工艺，包括涂胶、显影、湿法蚀刻和刷洗，计划于 2025 年上半年交付。
	9月6日	财联社	荷兰政府宣布扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，即从 9 月 7 日起，更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。
AI	9月3日	芯智讯	联发科：在 SEMICON Taiwan 2024 展会活动中，比利时微电子研究中心 (imec) 举行了“ITF Taiwan 2024 技术论坛”，联发科 CEO 蔡力行在该论坛上表示，AI 数据中心相关需求来得比预期多又快，这对于半导体业来说是一大机遇，联发科将进军 AI 服务器市场。同时他还透露，天玑 9400 将会在 10 月正式发布。
	9月5日	财联社	特斯拉：特斯拉人工智能团队在社交平台发布消息称，预计 2025 年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶 (FSD) 系统，但仍有待监管批准。
	9月5日	艾邦 VR 产业 资讯	京东方：成功研发出 0.9 英寸 6020 PPI 4K4K 智能屏分显示模组，该模组将原生 4K4K 显示与原生 HDR 技术完美结合，完成超高清 VR 眼镜的技术开发，同时，通过空间配置优化及组件轻量化，实现了 150g 超轻 VR 眼镜方案。
SiC	9月1日	南京发布官微	国家第三代半导体技术创新中心(南京)历时 4 年自主研发，成功攻关沟槽型碳化硅 MOSFET 芯片制造关键技术，打破平面型碳化硅 MOSFET 芯片性能“天花板”。据悉，这是我国在这一领域的首次突破。
汽车电子	9月5日	财联社	领克：首款 C 级轿车 Z10 上市，上市限时价为 19.68 万-28.88 万元，根据续航、快充平台、智驾的不同，共分为 5 个版型。新车基于 400V 和 800V 双平台打造，搭载马卡鲁计算平台 (AMD V2000A) 及 Flyme Auto 车机系统，配备 5C 金砖电池、双腔空悬+CCD+四活塞卡钳。
	9月5日	公司公告	蔚来：公司发布 2024 年二季度财报，营收和交付量双创新高：二季度营收 174.5 亿元，同比增长 98.9%，环比增长 76.1%；交付量 5.74 万台，同比增长 143.9%，环比增长 90.9%；整车毛利率 12.2%，同比提升 6 个百分点，环比提升 3 个百分点；研发支出 32.2 亿元，现金储备 416 亿元，亏损同比大幅收窄 16.7%。
	9月6日	IT之家	长城汽车：8 月海外销量达到 40454 辆，同比增长 31.6%，创下海外单月销量的新纪录。今年 1-8 月，长城汽车海外销量累计达到 280139 辆，同比增长 54.2%。
消费电子	9月4日	TrendForce 官微	根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，2024 年第二季由于部分品牌新机铺货期结束，加上季底进入库存调节等因素，全球智能手机生产总数落在 2.86 亿支，较第一季下降约 3%。由于旺季需求疲软，品牌厂在第三季的生产规划普遍趋于保守。因此，第三季生产总数预估仅有微幅季增，达 2.93 亿支，但仍较去年同期呈现约 5% 的下降。

	9月8日 华为终端	华为：三折叠手机华为 Mate XT 非凡大师于9月7日 12:08 开启预订。截至9月8日上午 10:50，预订开启不到 24 小时，华为商城显示该产品预约人数已超 200 万。
存储	9月6日 全球半导体观察	SK 海力士：社长金柱善 (Kim Ju Seon) 分享了 SK 海力士现有 HBM 产品规划。Kim Ju Seon 预计，SK 海力士将于 9 月开始量产其 12 层第五代高带宽存储器 HBM3E 产品，时间点早于原先规划的第四季度。

资料来源：国投证券研究中心整理

2. 行业数据跟踪

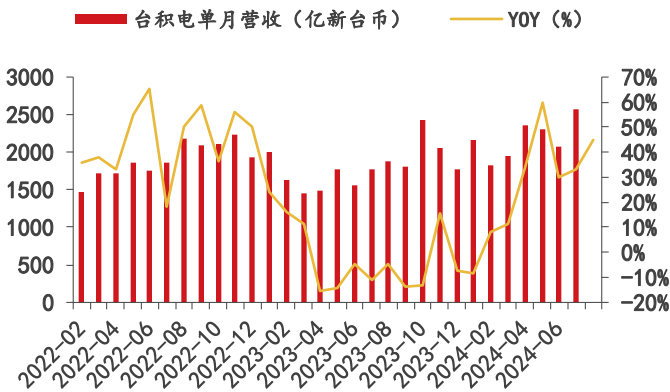
2.1. 半导体：二季度供应链急单助力晶圆代工利用率，全球前十大晶圆代工产值季增 9.6%

根据全球市场研究机构 TrendForce 集邦咨询调查显示，二季度中国 618 年中消费季的到来，以及消费性终端库存已回归健康水平，客户陆续启动消费性零部件备货或库存回补，推动晶圆代工厂接获急单，产能利用率显著提升，环比明显改善。同时，AI 服务器相关需求续强，推升第二季全球前十大晶圆代工产值季增 9.6% 至 320 亿美元。

从排名来看，前五大晶圆代工厂商二季度保持不变，依次为 TSMC（台积电）、Samsung（三星）、SMIC（中芯国际）、UMC（联电）与 GlobalFoundries（格芯）。在六至十名中，VIS（世界先进）受惠 DDI（显示驱动芯片）急单及 PMIC（电源管理芯片）红利带动出货增长，排行升至第八位；PSMC（力积电）、Nexchip（合肥晶合）则分别降至第九和第十位。排行依次为 HuaHong Group（华虹集团）、Tower（高塔半导体）、VIS、PSMC 与 Nexchip。

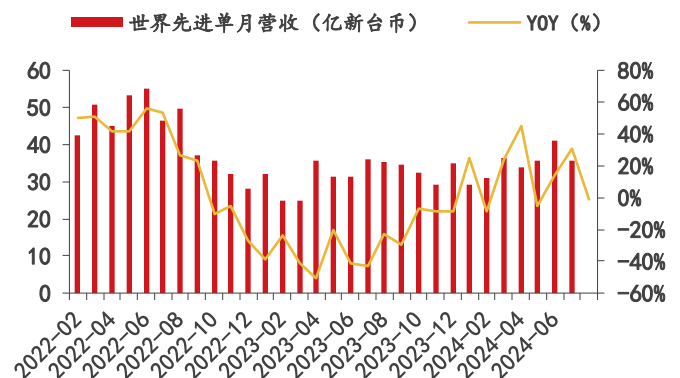
2024 年 7 月台积电单月营收 2569.53 亿新台币，同比增长 44.67%，环比增长 23.61%。世界先进 2024 年 7 月营收 35.57 亿新台币，同比下降 1.11%，环比下降 13.37%。联电 2024 年 8 月营收 2.6.45 亿新台币，同比增长 8.93%，环比减少 1.20%。

图1. 台积电月度营收



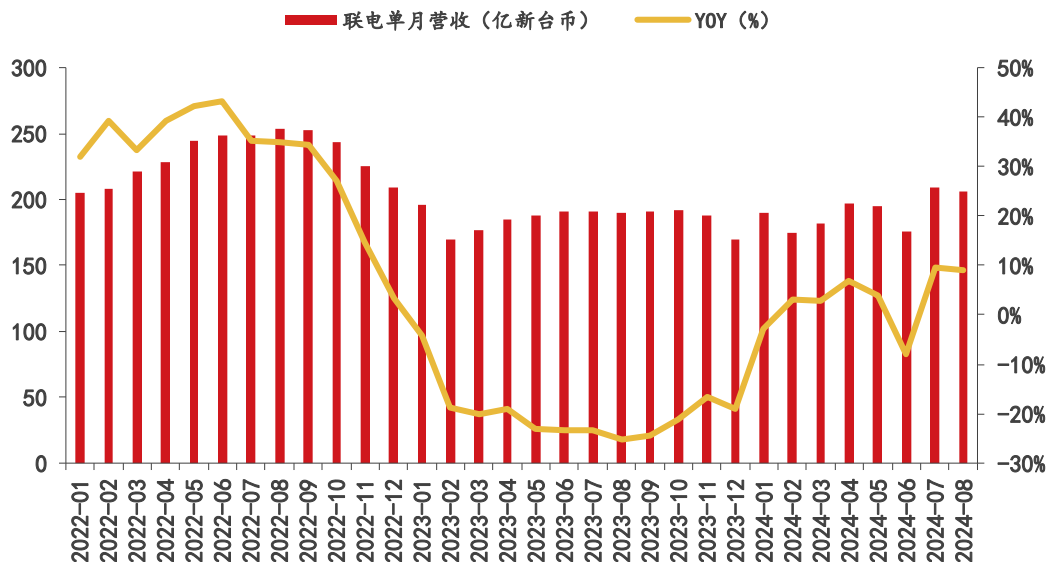
资料来源：台积电公司官网，国投证券研究中心

图2. 世界先进月度营收



资料来源：世界先进公司官网，国投证券研究中心

图3. 联电月度营收



资料来源：联电公司官网，国投证券研究中心

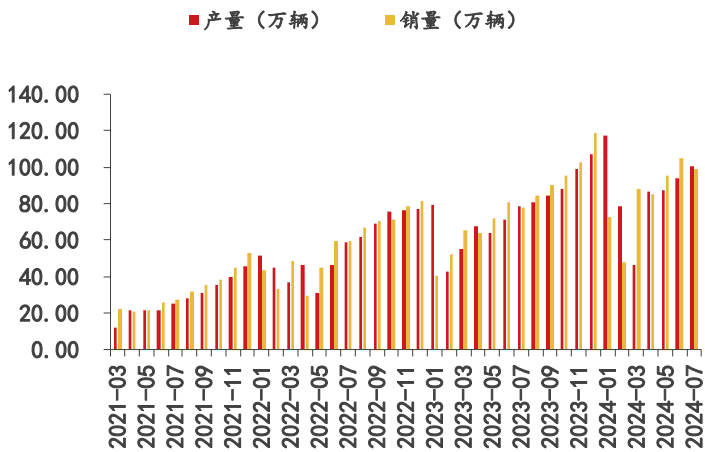
2.2. SiC: 芯片制造关键技术首次突破

9月1日，南京发布消息，国家第三代半导体技术创新中心（南京）历时4年自主研发，成功攻关沟槽型碳化硅 MOSFET 芯片制造关键技术，打破平面型碳化硅 MOSFET 芯片性能“天花板”。据悉，这是我国在这一领域的首次突破。

由中汽协公布的新能源车产销量数据，2024年7月，国内新能源汽车产量由去年80.50万辆增长至98.44万辆，销量由去年78.02万辆增长至99.05万辆。7月产销量仍保持同比增长，汽车消费端需求旺盛。

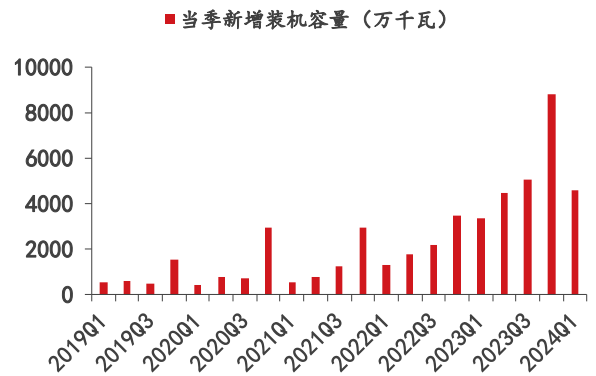
光伏方面，国内近年来季度光伏安装量增长迅速，据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，2024Q1国内光伏新增装机达到45.74GW，环比减少47.99%，同比增长35.89%。光伏产业的迅速发展同样能够带动对第三代半导体（碳化硅）功率器件的需求。

图4. 新能源汽车产销量情况



资料来源：中国汽车工业协会，Wind，国投证券研究中心

图5. 光伏装机情况



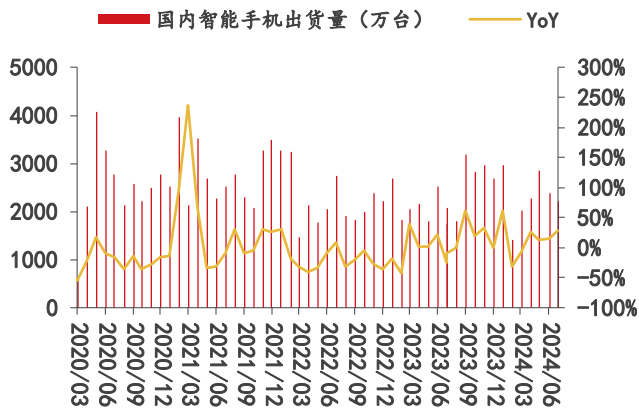
资料来源：国家能源局，国投证券研究中心

2.3. 消费电子： 华为三折叠屏手机开启预订，超 200 万人预约

9 月 7 日，华为三折叠屏手机正式开启预订。海报还正式公布了华为三折叠的外观，采用独特镜头纹理，以及高辨识度的小金标。据悉，这款产品将于 9 月 10 日的华为发布会上正式推出，价格也有待届时揭晓，将于 9 月 20 日正式开售。预订通道刚开启，人数就迅速破万，预订开启不到 24 小时，华为商城显示该产品预约人数已超 200 万。

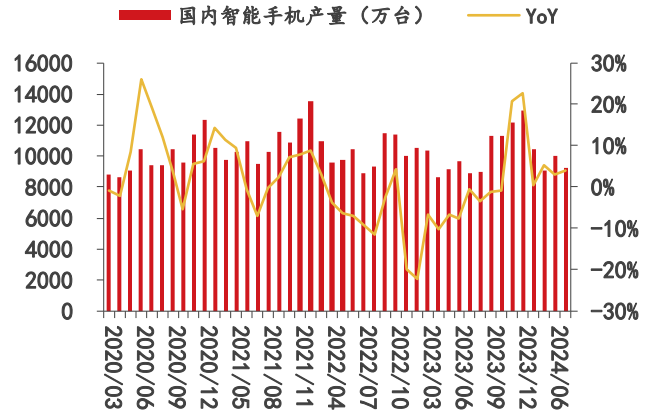
智能手机：据中国信通院，2024 年 7 月中国智能手机出货量为 2217.4 万台 (YoY+28.3%，MoM-7.0%)；据国家统计局，2024 年 7 月中国智能手机产量为 9234 万台 (YoY+4.0%，MoM-7.5%)。

图6. 国内智能手机月度出货量



资料来源：Wind，中国信通院，国投证券研究中心

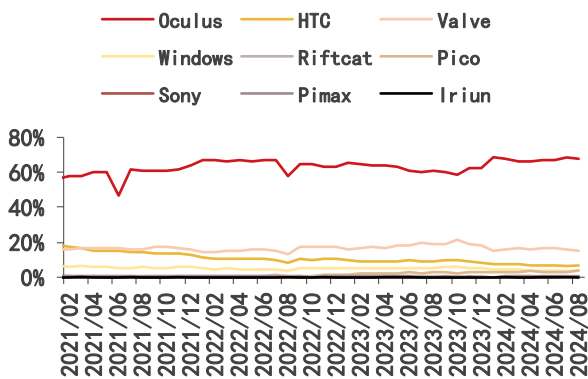
图7. 国内智能手机月度产量



资料来源：Wind，国家统计局，国投证券研究中心

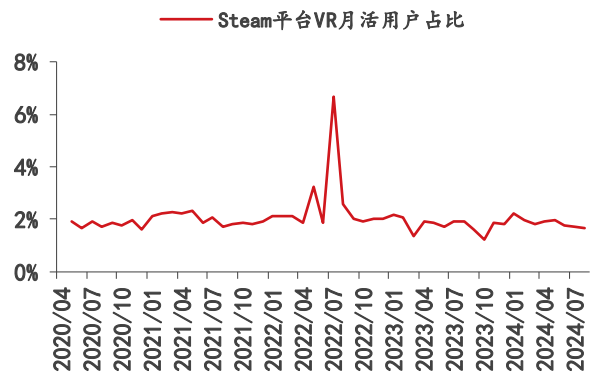
VR：据 Steam，2024 年 8 月 Oculus 在 Steam 平台的份额占比为 67.56%，YoY+7.05pct，MoM-0.71pct，而 Pico 份额占比为 3.94%，YoY+1.01pct，MoM+1.05pct；Steam 平台 VR 月活用户占比为 1.69%，YoY-0.23pct，MoM-0.04pct。

图8. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额



资料来源：Steam，国投证券研究中心

图9. Steam 平台 VR 月活用户占比



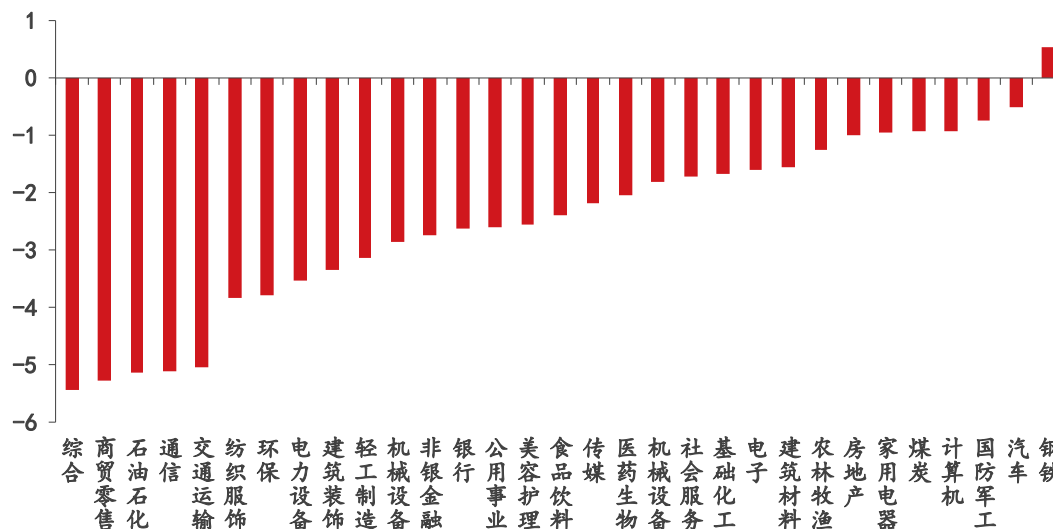
资料来源：Steam，国投证券研究中心

3. 本周行情回顾

3.1. 涨跌幅：电子排名 22/31，子板块中其他电子跌幅最小

- 全行业：本周（2024.09.02-2024.09.06）上证综指下跌 2.69%，深证成指下跌 2.61%，沪深 300 指数下跌 2.71%，申万电子板块下跌 5.27%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 22/31。2024 年，电子板块累计下跌 17.49%。

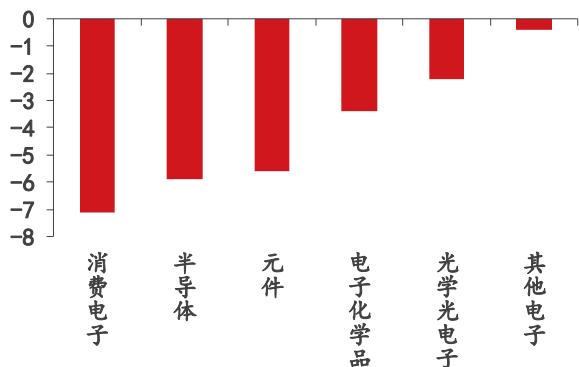
图10. 本周各行业板块涨跌幅（申万一级行业分类）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

- 电子行业：本周（2024.09.02-2024.09.06）其他电子跌幅最小，为-0.42%；消费电子跌幅最大，为-7.12%。

图11. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万二级行业分类；%）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

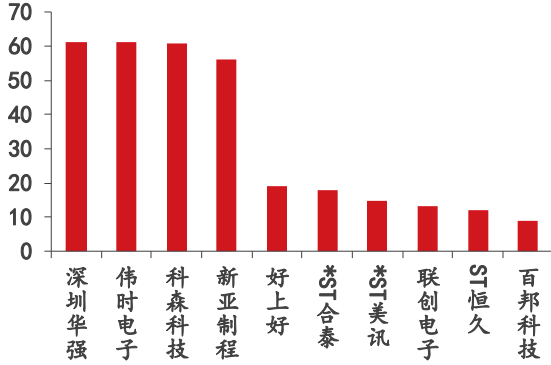
图12. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万三级行业分类）

申万二级行业名称	周涨跌幅 (%)	申万三级行业名称	周涨跌幅 (%)
半导体	-5.88	分立器件	-4.80
		半导体材料	-4.50
		数字芯片设计	-5.97
		模拟芯片设计	-5.14
		集成电路封测	-6.99
		半导体设备	-6.91
元件	-5.60	印制电路板	-6.10
		被动元件	-4.45
光学光电子	-2.22	面板	-1.65
		LED	-3.38
		光学元件	-2.59
其他电子	-0.42	其他电子	-0.42
消费电子	-7.12	品牌消费电子	0.12
		消费电子零部件及组装	-8.09
电子化学品	-3.37	电子化学品	-3.37

资料来源：Wind，国投证券研究中心

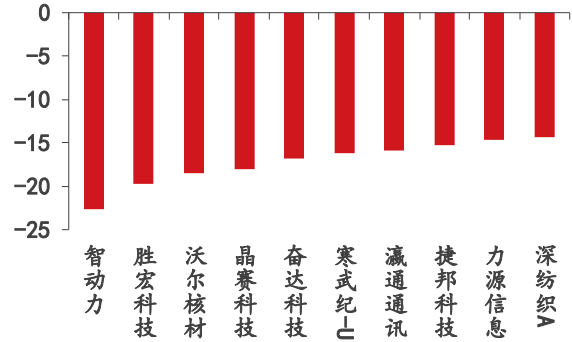
- **电子标的:** 本周(2024.09.02-2024.09.06)电子板块涨幅前三公司分别为深圳华强(+61.05%)、伟时电子(+61.05%)、科森科技(+60.90%)，跌幅前三公司分别为智动力(-22.71%)、胜宏科技(-19.75%)、沃尔核材(-18.43%)。

图13. 本周电子板块涨幅前十公司 (%)



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

图14. 本周电子板块跌幅前十公司 (%)



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

3.2. PE: 电子指数 PE 为 27.72 倍, 10 年 PE 百分位为 15.79%

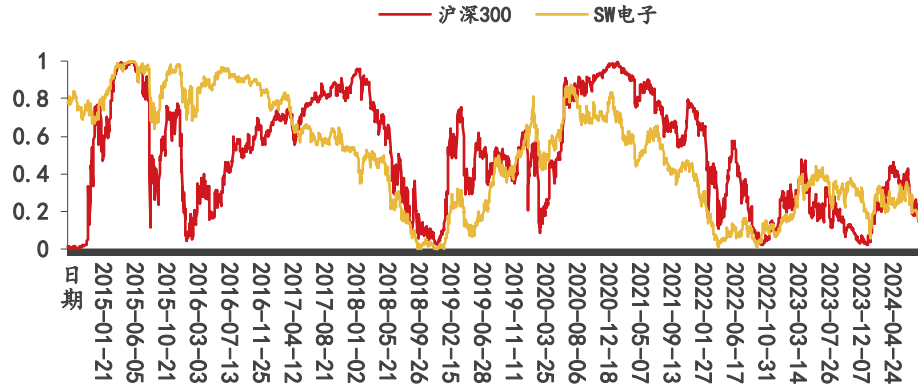
- **电子行业:** 截至 2024.09.06, 沪深 300 指数 PE 为 10.52 倍, 10 年 PE 百分位为 8.14%; SW 电子指数 PE 为 27.72 倍, 10 年 PE 百分位为 15.79%。

图15. 电子板块近十年 PE 走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

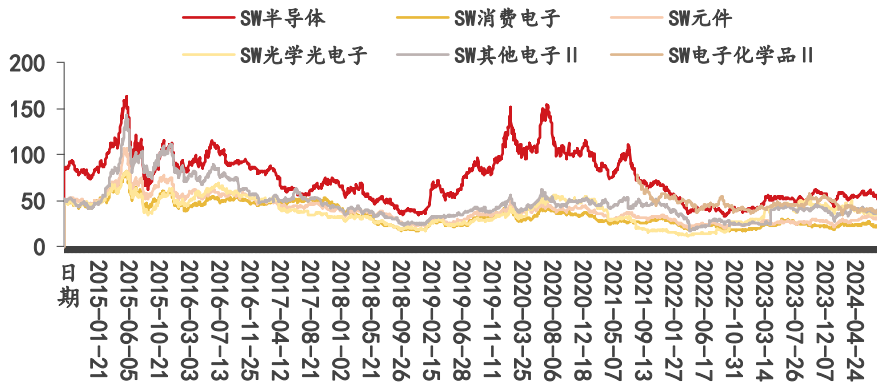
图16. 电子板块近十年 PE 百分位走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

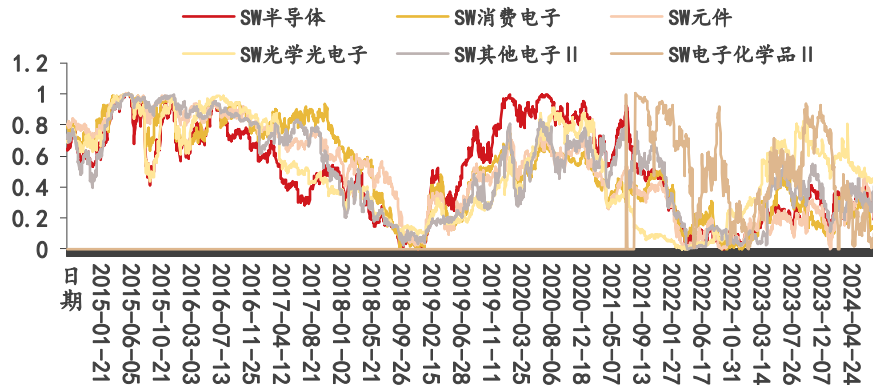
- **电子行业子版块:** 截至 2024. 09. 06, 电子行业子版块 PE/PE 百分位分别为半导体 (48.78 倍/16.20%)、消费电子 (20.80 倍/10.20%)、元件 (27.21 倍/21.88%)、光学光电子 (32.44 倍/38.45%)、其他电子 (44.47 倍/51.93%)、电子化学品 (39.33 倍/9.86%)。

图17. 电子板块子版块近十年 PE 走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

图18. 电子板块子版块近十年 PE 百分位走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

4. 本周新股

表2：本周 IPO 审核状态更新

	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
终止撤回					
已受理					
已问询					
已回复					
已审核通过					
报送证监会					
证监会注册					
正在发行					

资料来源：Wind，国投证券研究中心

目 行业评级体系

收益评级:

领先大市 —— 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%及以上;

同步大市 —— 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%;

落后大市 —— 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%及以上;

风险评级:

A —— 正常风险, 未来 6 个月的投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;

B —— 较高风险, 未来 6 个月的投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;

目 分析师声明

本报告署名分析师声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据, 特此声明。

目 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

国投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。

目 免责声明

本报告仅供国投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国投证券股份有限公司研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

国投证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

国投证券研究中心

深圳市

地 址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 33 楼

邮 编： 518026

上海市

地 址： 上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 28 层

邮 编： 200082

北京市

地 址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮 编： 100034